報道発表資料様式

１２／２３（火）の行事

【道庁プレスリリース】

報道発表資料の配付日時　　12月 3日（水）10時00分

発表項目（行事名）	道民向けセミナー「次世代半導体とほっかいどうの未来 in 函館」の開催について		
記者レクチャーのお知らせ	（実施日時）	発表者	
		発表場所	
概要	道では、この度、ラピダス社のプロジェクトをはじめ、半導体が私たちの暮らしや未来をどのように変えていくのかについて道民の皆様の理解を深めていただくため、道民向けセミナーを函館市で開催しますので、お知らせします。 ＜開催概要＞ １．日時：令和７年（2025年）12月23日（火）15:00～17:00 ２．場所：函館市中央図書館　視聴覚ホール （函館市五稜郭町26-1） ※オンラインライブ配信あり（申込み必要） ３．定員：100名（参加無料、先着順） ４．講師：北海道大学 量子集積ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究ｾﾝﾀｰ 特任教授 熊倉 一英 氏 横浜国立大学 半導体量子集積ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 井上 史大 氏 ソフトバンク(株) 次世代社会インフラ推進室 企画部 部長 堀川 学 氏 ※詳細は、別添チラシ参照		
参考	・申込みは、チラシに記載のURLまたはQRコードから行っていただきます。		

報道（取材）に当たってのお願い	・当日の取材を希望される場合は、下記担当までお知らせください。
他のクラブとの関係	同時配付 同時レク

担当（連絡先）	経済部 AI･DX推進局 次世代半導体戦略室（担当者：野並） ＴＥＬ　ダイヤルイン　０１１－２０６－９０９０　内線２６－３１４

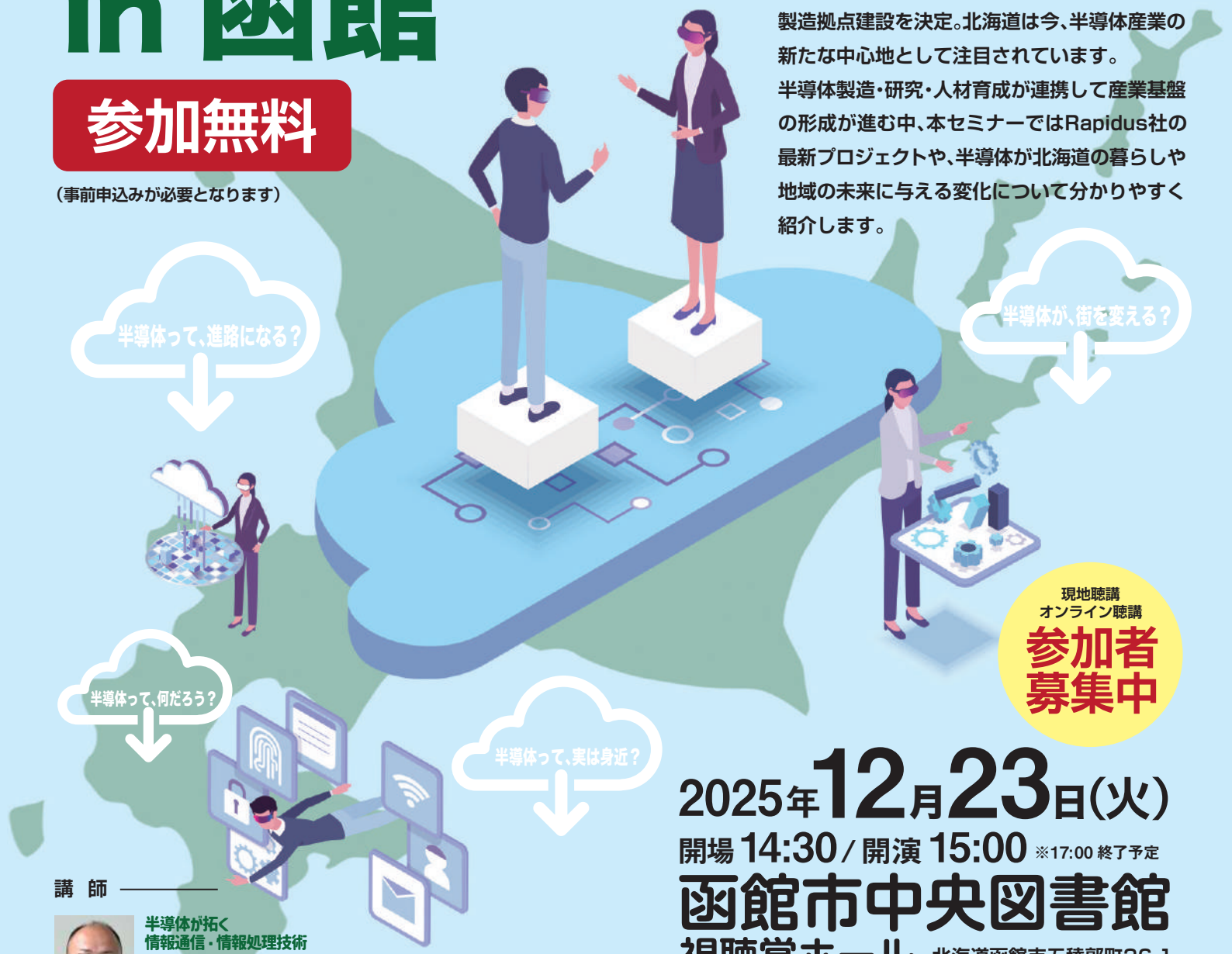
北海道

次世代半導体と ほっかいどうの未来 in 函館

参加無料

（事前申込みが必要となります）

2023年、Rapidus社が千歳市に最先端半導体製造拠点建設を決定。北海道は今、半導体産業の新たな中心地として注目されています。
半導体製造・研究・人材育成が連携して産業基盤の形成が進む中、本セミナーではRapidus社の最新プロジェクトや、半導体が北海道の暮らしや地域の未来に与える変化について分かりやすく紹介します。



現地聴講
オンライン聴講
参加者募集中

2025年12月23日(火)

開場 14:30 / 開演 15:00 ※17:00 終了予定

函館市中央図書館 視聴覚ホール

北海道函館市五稜郭町26-1

募集定員 100名

参加の申込みは先着順となります。

※定員は現地で聴講いただける人数となります。
※オンラインでの聴講も募集します。

講 師

半導体が拓く 情報通信・情報処理技術
北海道大学
量子集積エレクトロニクス研究センター
特任教授
熊倉 一英 氏

AI向け先端半導体のための チップレット連携基盤と エコシステム構築
横浜国立大学
半導体量子集積エレクトロニクス研究センター 副センター長
井上 史大 氏

ソフトバンクの考える 次世代社会インフラ構想
ソフトバンク株式会社
テクノロジーユニット統括
次世代社会インフラ推進室 企画部 部長
堀川 学 氏

■ お問い合わせ
令和7年度半導体産業に係る複合拠点化事業（道民向けセミナー）受託 コンソーシアム
代表者：株式会社北海道新聞社 担当：大和
電話：011-210-5902 10:00~17:00（土日祝除く）

■ 申込方法 https://moula.jp/LP/next-sc/
右記の2次元コードより、「現地聴講」または「オンライン聴講」どちらかご希望の参加方法を選択し、必要な情報をご入力の上お申し込みください。

主催：北海道経済部AI・DX推進局次世代半導体戦略室

次世代半導体とほっかいどうの未来 in 函館

プログラム

15:00～15:15	あいさつ 北海道半導体・デジタル関連産業振興ビジョンと道の取組	北海道経済部	
15:15～15:30	半導体政策について	経済産業省 北海道経済産業局	
15:30～16:00	講　演①／半導体が拓く情報通信・情報処理技術	北海道大学 量子集積エレクトロニクス研究センター 特任教授	熊倉 一英 氏
16:00～16:30	講　演②／AI向け先端半導体のためのチップレット連携基盤とエコシステム構築	横浜国立大学 半導体量子集積エレクトロニクス研究センター 副センター長	井上 史大 氏
16:30～16:55	講　演③／ソフトバンクの考える次世代社会インフラ構想	ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット統括 次世代社会インフラ推進室 企画部 部長	堀川　学 氏
16:55～17:00	質疑応答（事前にいただいた質問への回答）		

講師紹介

半導体が拓く情報通信・情報処理技術

北海道大学
量子集積エレクトロニクス研究センター
特任教授

熊倉 一英 氏

1998年　日本電信電話株式会社（現 NTT株式会社）入社
　　NTT基礎研究所（現 物性科学基礎研究所）配属
　　窒化物半導体の高効率エネルギー変換素子に関する研究に従事
2007年　独 Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik 客員研究員（1年間）
2015年　NTT物性科学基礎研究所 薄膜材料研究グループ グループリーダー／特別研究員
2019年　NTT物性科学基礎研究所 企画担当 主席研究員
2022年　NTT物性科学基礎研究所 所長
2024年10月　北海道大学 量子集積エレクトロニクス研究センター 特任教授
　　現在に至る

AI向け先端半導体のためのチップレット連携基盤とエコシステム構築

横浜国立大学
半導体量子集積エレクトロニクス研究センター
副センター長

井上 史大 氏

2011年～2021年　ベルギーimecにて3Dパッケージングの研究に従事
2021年　横浜国立大学、准教授
2024年4月　同大学、半導体量子集積エレクトロニクス研究センター
　　副センター長に着任
2025年3月　LSTC3Dパッケージング部門の副部門長
　　現在に至る

ソフトバンクの考える次世代社会インフラ構想

ソフトバンク株式会社
テクノロジーユニット統括
次世代社会インフラ推進室
企画部 部長

堀川　学 氏

1985年　劇団いろは 所属
2005年　ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社し、
　　光サービスの施工管理業務に従事
　　ボーダフォン買収後、モバイル事業の中長期戦略策定、
　　5G導入に従事
2020年　ネットワーク・ロボット・IoTなどの先端技術を活用した
　　法人向けソリューションの技術および事業企画を担当
2023年　北海道苫小牧AIデータセンタープロジェクトの推進
　　現在に至る

主催：北海道経済部AI・DX推進局次世代半導体戦略室